呉工業高等専門学校				開講年度	平成30年度 (2	2018年度)	授			特別講義    'トロニクス			
科目基	礎情報										1	<del></del>	
科目番号	<del> </del>	C	040				科目区分		専門 / 必何	多			
受業形態 講義							単位の種別と単位		学修単位:				
			クトラ	デザイン工学専	攻	対象学年 専2							
開設期前期							週時間数 2						
教科書/教材													
担当教員	Į	L	山脇 正雄	É									
到達目	標												
実際のデ	バイスを低	もう際に	こ必要と	なる	メーカー提供の	 )データを理解し,	<del></del> それが使えるよう	に理解る	を深める				
ルーブ	リック					·							
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				理		 ベルの目安	標準的な到達レベルの目安未到達レ			未到達レ	 ベルの目安		
						などを十分に理解 使うことができる	)に理解 デバイス仕様書などの概要を することができる			デバイス仕様書などを理解できす , 使うこともできない			
。 最先端の半導体					先端の半導体	デバイスの動向と 最先端半導体の大まかな動			動向を理	最先端半導体について理解できな			
	-			原	理を理解できる	5	()		()				
評価項目		·	1 - 25	<i>IT</i>			1			1			
	到達目標												
		排標 専	以料の学	'習・	教育目標 (SC)								
教育方	法等												
概要		星	今日では 各が実現で で考慮す	応用回 できる	回路がICとして る。ICを利用す 訓約条件などを	供給され、目的( る立場から、ICを 理解する。また最	仕様)にあったIC 構成する回路技術 先端のデバイスに	を選択した動作、	ノ, これに 更にはIC 野解を深め	周辺回路を の構造など ス	付加すること を学び、ICを	で目的の回れます。	
					き制約条件などを理解する。また最先端のデバイスについて理解を深める。 バイスを事例として、メーカから提供されているデータシートなどを用いて動作原理や使い方を理解する。								
ix来の進 注意点	/ /3/.	<del>-   -</del>	~rm~JJ /	1/	, C 7 1/3 C O C	, , ,,,, JJENC1		, ,,,,	<u>ニ/コマ・C 野</u>	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	~ ~ ~ J C-ED+ 3		
<u> </u>	 雨i												
以未引	<u>岡</u>	週	I	授業区	 カ突			調ブレ	の到達日価				
						週ごとの到達目標 さと使い方をメーカー発行のマニュア							
		1退	2	ルを	用いて学習する	3			デジタルLSIの構成と動作				
		2退	<u> </u>	デジ	タルLSIの種類	と使い方をメーカ-	一発行のマニュア <sub>インターフェー</sub> ス技術の詳細			細			
		3退	B .	デジ	タルLSIの種類	と使い方をメーカー発行のマニュア		  ソフトウエア:内部設定					
		4退	8	デジ	用いて学習する タルLSIの種類 用いて学習する	と使い方をメーカー発行のマニュア、ノフトウェス・信号が囲む。			o -				
	1stQ	 5週		センサ	/を用いて子首する !ンサーICの種類と応用をメーカ発行のマニュアルを用い :学習する				光センサーの構造と原理				
		6退		セン!		と応用をメーカ発行のマニュアルを用い		加速度センサーの構造と原理					
前期		7退		セン!	ンサーICの種類と応用をメーカ発行のマニュアルを用い 学習する				距離センサーの構造と原理				
		8退		セン!	ンサーICの種類と応用をメーカ発行のマニュアルを用い 学習する			センサーネットワークの構成					
		9退	<u> </u>	最先述	端高周波デバィ	(ス		デバイ	ス構造				
		10	週	最先如	た端高周波デバイス た端高周波デバイス			性能を決める要因					
		11	週	最先站				電気特性モデリングと寄生素子					
	2540	12	週	最先如	端高周波デバイス			さまざまな高周波デバイスの例:GUNダイオード					
	2ndQ	13			先端高周波デバイス 発端マイコンデバイス				さまざまな高周波デバイスの例: ヘテロ接合 アーキテキチャ				
		14											
		15	15週 最		先端マイコンデバイス				高速化手法				
		16	16週 最知		先端マイコンデバイス				低消費電力化手法				
<u>モデ</u> ル:	<u>コア</u> カリ	<u>キ</u> ュ	<u>ラム</u> の	学 <u>習</u>	内容と到達	目標							
分類			分野		学習内容	学習内容の到達目	票			<u> </u>	到達レベル	授業週	
						電子の電荷量や質量などの基本性質を説明できる。			5	前1			
						エレクトロンボルトの定義を説明し、単位換算等の計算ができる。		5	前1				
			専 電気・電 <del>-</del> 系分野		<sup>2</sup> 電子工学	原子の構造を説明できる。			5	前1			
						パウリの排他律を理解し、原子の電子配置を説明できる。		5	前1				
専門的能	分野原	の専				結晶、エネルギーバンドの形成、フェルミ・ディラック分布を理解し、金属と絶縁体のエネルギーバンド図を説明できる。			5	前1			
	1. 3.4.					金属の電気的性質を説明し、移動度や導電率の計算ができる。			5	前2			
					1 -	□ 直角の電気の任実ができる。 ■ 真性半導体と不純物半導体を説明できる。		5	前2				
						学体のエネルギーバンド図を説明できる。				5	前2		
					1	pn接合の構造を理解し、エネルギー							
					1 -				対を田いて	nn接合の	5	前3,前5,	

			) F	バイポーラトラ! 用いてバイポー	ンジスタの構造で ラトランジスタの	を理解し、エネルギーバ の静特性を説明できる。	(ンド図を	5	前3,前5,前 14			
			į	電界効果トランジスタの構造と動作を説明できる。				5	前3,前5,前 14			
評価割合												
	試験	発	表	相互評価	態度	ポートフォリオ	その他	合語	†			
総合評価割合	70	0		0	0	30	0	10	0			
基礎的能力	70			0	0	30	0	10	0			
専門的能力	0		•	0	0	0	0	0				
分野横断的能力	的能力 0			0	0	0	0	0				